

組立後の洗浄工程削減へ!

Eliminate cleaning process after assembly!

フラックス残渣レスペースト

Less flux residue paste

NP303-FLV-T4

フラックス残渣が残らず**洗浄不要!**

Since flux residue does not remain, cleaning is unnecessary!

Niなどのヌレにくい母材に対しても**ヌレ性良好!**

Wettability to the parts that are hard to be wet like Ni are also good!

N2+真空リフロー対応で**ボイド発生を抑制!**

Suppress occurrence of void by N2 + vacuum reflow furnace!

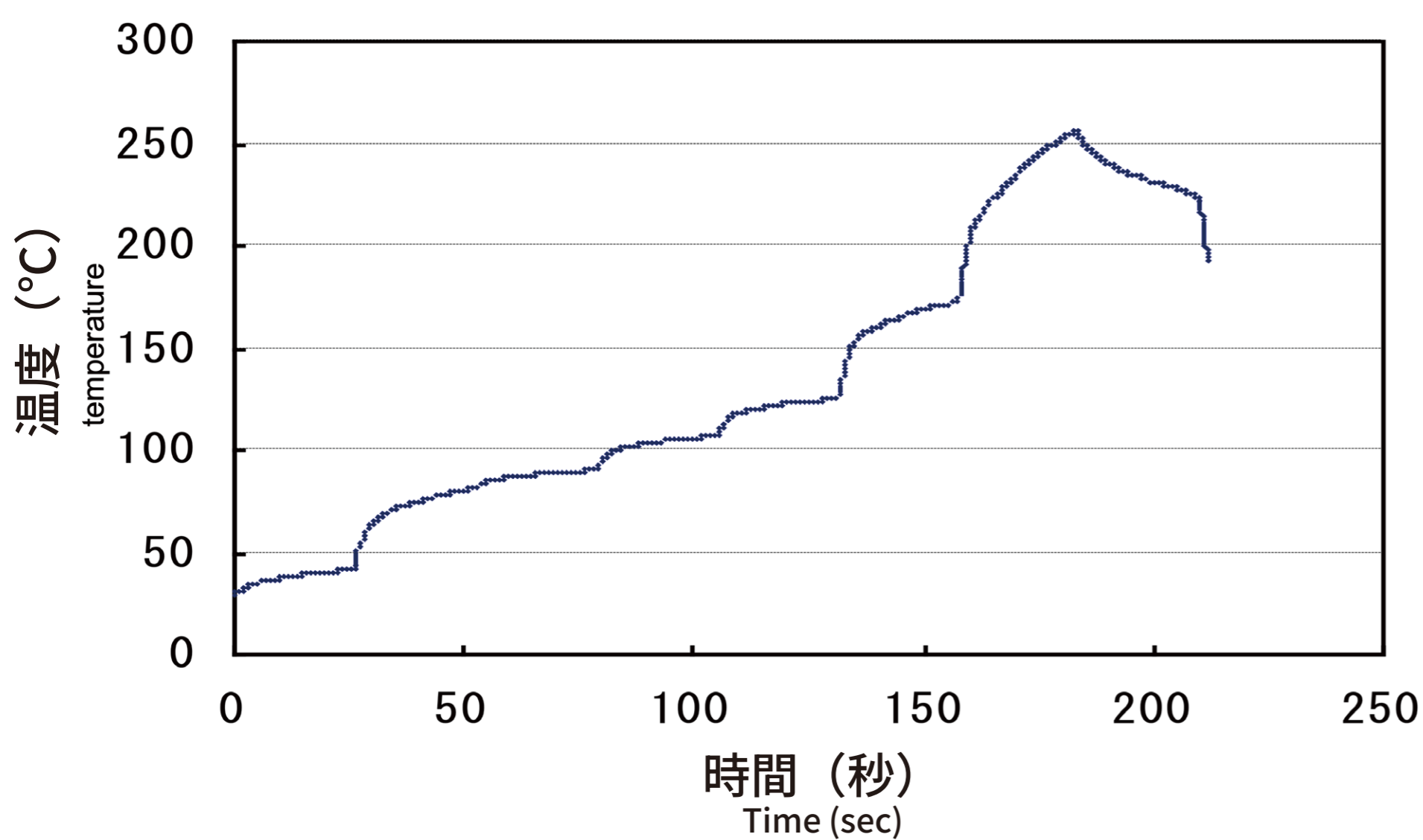
揮発によるフラックス残渣抑制

Suppression of flux residue by volatilization

	残渣レスペースト Less flux residue solder paste	一般ペースト Normal solder paste
2125C		 フラックス残渣 Flux residue
2125C SEM		 フラックス残渣 Flux residue

推奨リフロープロファイル

Recommended reflow profile



	試験条件 Test condition	推奨条件 Recommended conditions
昇温速度 Temperature increase rate	1.0sec.	2sec.以下
プリヒート (100°C-170°C) Preheat	60.8sec.	40-70sec.
昇温速度 (170°C-220°C) Temperature increase rate	4.6°C/sec.	4°C/sec.以上
>220°C	46sec.	30-90sec.
ピーク温度 Peak temperature	260.6°C	250-270°C
酸素濃度 Oxygen concentration	500ppm	500ppm以下
真空到達度 Degree of vacuum	3.9kPa	10kPa以下

ギ酸リフロー対応

フラックス残渣レスペースト

Less flux residue paste applied for formic acid reflow

NP303-FL001-T4

ギ酸リフローにより**フラックス残渣、ボイドゼロ!**

No flux residue and void due to formic acid reflow!

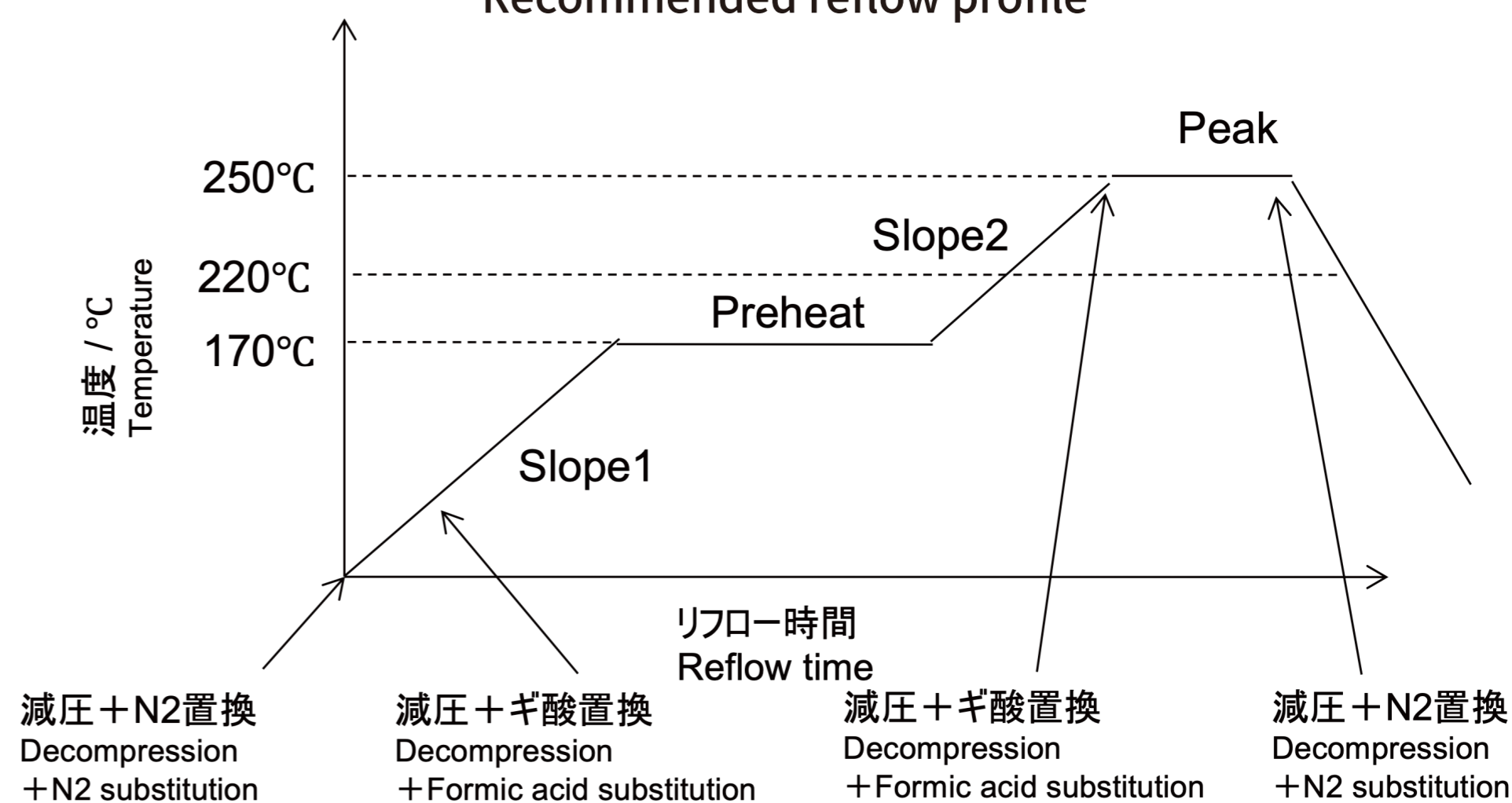
ギ酸リフロー性の検証結果

Test result of reflowability for Formic acid reflow

外観写真 Exterior Photograph	X線透過写真 X-ray Transmission Photograph	Cu板濡れ写真 Cu plate wetting photograph
ぬれ性良好 Good wettability フラックスの残留無 No flux residue	ボイド無 No void	フラックスの残留無 No flux residue

推奨リフロープロファイル

Recommended reflow profile



Step	条件 Conditions
Slope1, 2	2.0°C/sec以内 within 2.0°C/sec
Preheat	170°C、60sec以上 more than 170°C60sec
Peak	Sn3Ag0.5Cuの融点 (217°C)+15°C以上 melting point of Sn3Ag0.5Cu+ more than 15°C
220°C以上 (半田の融点以上) More than 220°C (more than melting point of solder)	30sec以上 more than 30sec
ギ酸導入のタイミング Supply timing of formic acid	Preheat前とPeak温度前に2回 Total of 2 times before preheat and peak temperature

